











Webinaire

Mastère Spécialisé Concepteur de Circuits Microélectroniques 30 janvier 2025

Jean-Max Dutertre

Responsable pédagogique

dutertre@emse.fr

Zohra Malki

Inscriptions

ms-mcm@mines-stetienne.fr



Funded by the European Union

Edu4Chip - Joint Education for Advanced Chip Design in Europe is funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



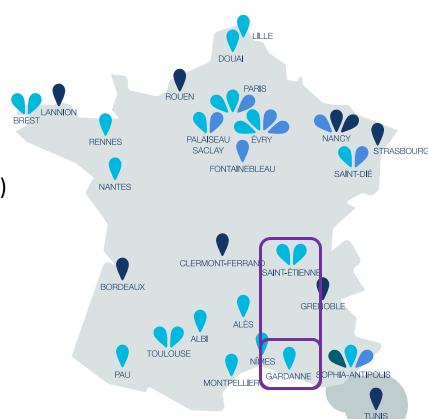




Cadre - Lieu

Porté par Mines Saint-Etienne

- Ecole de l'Institut Mines-Télécom
- Campus : St-Etienne, Gardanne et Lyon
- 6 diplômes d'ingénieurs (form. init. et salarié)
- 13 Masters Recherche
- 8 Mastères Spécialisés
 - => 2500 Etudiants
- 5 centres de recherche









Au sein du Centre de Microélectronique de Provence

- Situé à Gardanne (13, prox. Aix-en-Provence/Marseille)
- Centre enseignement et recherche
- ~ 110 personnes
- Salle blanche, moyens exp.
- Spécialisé en Microélectronique
 - Elec. flexible
 - Bioélectronique
 - Sécurité des composants
 - Sciences de fabrication et logistique
- MS DSD IoT, MS CCM, ISMIN





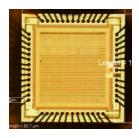


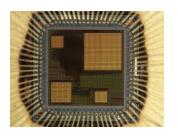


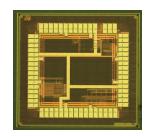
Contexte

Industrie Microélectronique

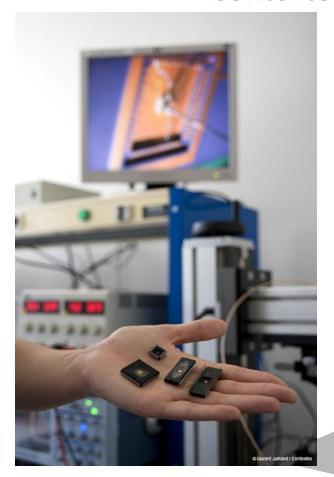
- Fabrication composants s.c. / circuits intégrés
- Circuits conçus au CMP par l'équipe enseignante du MS CCM :







- Intégration des circuits dans cartes électroniques et systèmes complexes
- Industrie stratégique au cœur de la compétitivité des industries et de leur évolution









Contexte - Industrie Microélectronique

Une industrie complexe avec de nombreux métiers/domaines

Market USD

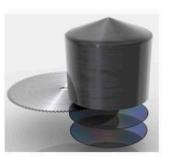
\$10B

Value chain

MATERIALS Raw Silicon Wafer manufacturing

Profit level

- GM ~30-40%
- Few players



Expl. SOITEC (Grenoble)

\$83B

FOUNDRY Semiconductor Manufacturing

- GM ~30-50%
- Massive investment game (TSMC, Intel)



Expl. ST Micro (Rousset, Grenoble)

\$59B

OSAT: Outsourced Semiconductor Assembly and Test

- GM ~10-20%
- Labor intensive (low GM)

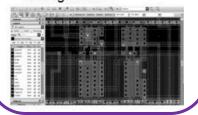


MS CCM

\$128B

FABLESS, ODM, (OEM)
Design without own
fabrication

- Fabless GM ~40-60%
- ODM GM ~35-70%
- High value in innovation
- Highest GM in succesfull ODMs who master both Design+FAB



En région Sud : NXP, ST, Thales, Idemia, SealSQ, Elsys design, ARM, Qualcomm, etc.









Développer/renforcer l'industrie Microélectronique en EU/France

European Chips Act:

- Enjeu de souveraineté : développer conception et fabrication de circuits intégrés en Europe
- Enjeu industriel : CI au cœur des transformations num., e.g. industrie automobile (rationnement des CIs post-Covid)
- Verrou : manque de concepteurs de CIs (num./analog.)
- 43 milliards d'euros d'investissements publics et privés d'ici 2030
- → Nombreux financements recherche & formation









Projet EU Edu4Chip

Objectifs:

- Formation de concepteurs circuits intégrés (IC) au niveau Master
- Programmes compatibles entre les universités partenaires + échanges étudiants
- Point marquant : conception et fabrication d'un IC par les étudiants pdt leur scolarité
- → Mastère Spécialisé Concepteur de Circuits Microélectroniques

















MS Concepteur de Circuits Microélectroniques Devenez un expert des semi-conducteurs

Former des experts en conception de circuits intégrés numériques et analogiques

Répondre aux besoins en experts de l'industrie microélectronique

Ouvrir les portes de l'industrie microélectronique aux diplômés en science et électronique







MS Concepteur de Circuits Microélectroniques Devenez un expert des semi-conducteurs

- Accréditation CGE (label Conf. des Gdes Ecoles)
- Formation Bac +6, suite d'un
 - Master 2
 - Diplôme ingénieur

Prérequis : formation de base scientifique & électronique

- Formation en alternance, 1 an
 - Expérience industrielle
 - Formation académique de haut niveau











Objectifs de la formation / Compétences acquises

- Maîtriser la conception et l'optimisation de circuits microélectroniques dans un contexte industriel
 - Choisir une technologie adaptée à l'application visée
 - Rédiger la spécification d'un circuit intégré
 - Réaliser la conception fonctionnelle d'un circuit intégré
 - Réaliser la synthèse logique d'un circuit intégré







Objectifs de la formation / Compétences acquises

- Développer des compétences avancées en modélisation, simulation et fabrication des circuits intégrés
 - Utiliser les outils de conception de circuits microélectroniques (EDA)
 - Réaliser la conception physique d'un circuit intégré (num. ou analog.)
 - Valider le design d'un circuit intégré
 - Adresser le design du circuit intégré validé à la fonderie (Tapeout)
- Répondre aux enjeux de performance, de miniaturisation et d'efficacité énergétique dans la microélectronique.
- Conduire un projet de conception de circuit intégré







Soutiens industriels

Lettres de soutien: NXP, ARM, Thales, ST, pôle Aktantis, CEA Leti, Elsys Design, Idemia











Equipe enseignante – comité MS

- Académique : enseignants cycles ingénieurs MSE, expérience en conception de circuits, chercheurs microélectronique et sécurité matérielle (SmartCards)
- Industriels: 43% (ST Micro, Elsys, NXP, etc.)

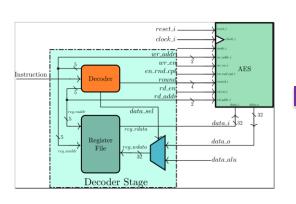




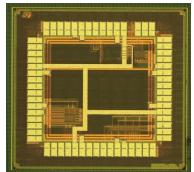


Innovation pédagogique – Conception circuit intégré

- Conception et fabrication d'un circuit intégré par les élèves
- Objectif d'acquisition des compétences par la pratique
 - Conception CI (HDL -> Tape out)
 - Envoi en Fab
 - Test applicatif circuit intégré

















Programme des cours

- Partie académique : 406h, 5 modules, 13/14 semaines au Campus Aix Marseille Provence
- Partie professionnelle : en alternance
 - Thèse professionnelle
 - Mission en entreprise 6 mois







Module 1 - Bases Microélectronique (84h)

- Bases des circuits numériques et analogiques Rappels
- Physique des semi-conducteurs
- Composants semi-conducteurs
- Process et fabrication de circuits intégrés

Socle commun, mise à niveau

Module 2

Conception analogique et numérique (91h)

- Conception de circuits numériques
- Conception de circuits analogiques
- Architecture des processeurs

Circuits num./analog., Processeurs RISC-V

Module 3

Flot de conception de circuits intégrés (91h)

- Synthèse et langages de description matérielle
- Simulation avancée et vérification
- Co-design et prototypage FPGA

Module 4 - Cours appliqués (70h)

- Conception de systèmes basse consommation
- Fabrication de transistors NMOS en salle blanche

Outils CAO, boîte à outil du concepteur

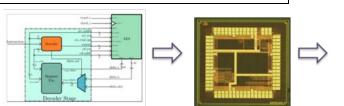






Module 5 - Conception d'un circuit intégré (70h)

Projet fil rouge de conception et fabrication d'un circuit intégré





Mise en pratique / expérience professionnelle

Thèse professionnelle

Recherche appliquée à un projet professionnel en entreprise, encadrement académique Rédaction d'une thèse -> généraliser la réflexion, prise de recul Soutenance devant jury

Mission en entreprise d'une durée de 6 mois

Mise en situation professionnelle autour d'un thème proposé par l'entreprise Comprend un accompagnement au Management de projet Formalisée dans la thèse professionnelle







Métiers – Témoignages

Témoignages : anciens élèves & partenaires industriels

• 1ère rentrée octobre 2025 (pas encore d'ancien élève, mais ...)



Ingénieur logiciel de connectivité – NXP Sophia Antipolis Ancien élève MSE

- MS DSD IoT, Gardanne
- Ingénieur SEE, MSE







Métiers – Témoignages

Témoignages : anciens élèves & partenaires industriels

Témoignage métiers - NXP



Ingénieur expérimenté Vérification SoC Hardware NXP Sophia Antipolis

Ancien élève MSE

Ingénieur ISMIN, Campus Gardanne
 Comité pédagogique, Comité de perfectionnement MS CCM



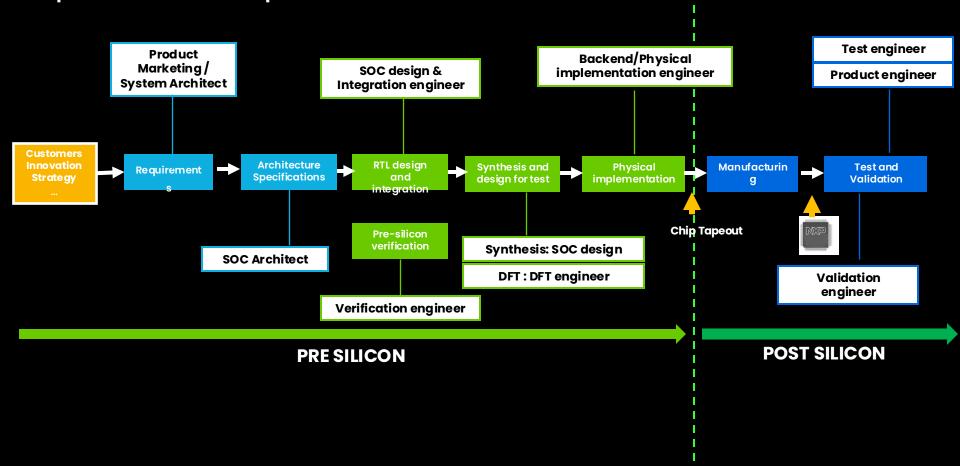
NXP expectations

Trying to match new MS-CCM

Senior Hardware SoC Verification Engineer
Guillaume Cardeur

| Internal | NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. © 2024 NXP B.V.

Chip hardware development flow



ARCHITECT

RTL

VERIF

DFT

- Safety
- Modelling
- Networking (PCIE, USB...)
- Hard focus on ASIC systems even if FPGA skills is nice to have
- Processors architecture
- Communication protocols
- Release + versioning skills
- Working as a team

- System Verilog vs VHDL
- Conception flow RTL to GDS
- Low power aspects (clk gating / UPF meaning + usage)
 - Security
 (physical
 attacks /
 counter
 measures
 SW/HW / crypto
 - IA machine learning HW

- Verification plan meaning
- UVM meaning + usage
- Scripting Python / TCL / Shell
- System Verilog
- C for SoC directed testcases
- CPU
 architecture,
 low power
 aspects,
 interrupts
- Coverage aspects

- Synthesis
- Scan + ATPG insertion + meaning about fault models + TP
- Theorical
 aspect of chip
 manufacturing
 (conception ->
 production)
- RTL + GATE level
- Scripting Python / TCL / Shell
- Timing constraints







Questions & Réponses

Session de Questions & Réponses

Pourquoi rejoindre le MS CCM?

Pour quels métiers, quels postes ?

Quelle formation/diplôme pour pouvoir candidater?

Comment trouver une alternance?

Vais-je trouver facilement du travail après le MS?









MS CCM – Contacts

Contacts, Informations

Jean-Max Dutertre

Responsable pédagogique

dutertre@emse.fr

Zohra Malki

Inscriptions, informations

ms-mcm@mines-stetienne.fr

Site web MS CCM -> https://www.mines-stetienne.fr/formation/mastere-specialise-concepteur-de-circuits-microelectroniques

Pour les informations, pour nous joindre

Pour récupérer la plaquette

Pour récupérer le dossier d'inscription

Mines Saint-Etienne -> https://www.mines-stetienne.fr